

**公司介绍**：

青芯半导体是中国集成电路行业的一颗新星，由一群在芯片领域深耕十几年的优秀人才创立，它发源于IBM（国际商业机器）的微电子部门，在过去的十几年中一直为中国和全球最顶级的公司（华为、中兴、爱立信、诺基亚、思科、日立、三星等）设计世界上最复杂的芯片。在“后摩尔定律”已然到来的时代，青芯半导体以“异构计算”作为其明确的未来技术发展路线，专注于为合作伙伴定制面向特定领域的硬件电路。

从应用领域来说，主要产品为智能网络及相关的数据处理加速；从实现方法来说，主要业务为ASIC SoC设计及验证框架，各类IP的集成，FPGA原型到芯片的转化，芯片物理设计，2D/3D封装和版图设计。在国产芯片行业的巨大机遇中，青芯带给行业并引领行业的，是脚踏实地、精益求精的专业精神，是客户至上、诚信负责的一贯态度。欢迎加入我们。

**薪酬待遇**

* 薪酬社保

本科生 12-20w，研究生15-25w, 五险一金

* 福利待遇

年终奖，年节礼品，商业保险，员工体检，灵活办公，带薪年假，双休，日常健身，团队建设

**应届毕业生需求一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 |
| 数字设计工程师 | 电子/集成电路 | 本科/硕士 |
| 数字验证工程师 | 电子/集成电路 | 本科/硕士 |
| 可测性设计工程师 | 电子/集成电路 | 本科/硕士 |
| 数字后端工程师 | 电子/集成电路 | 本科/硕士 |

**工作地点**

 上海，无锡

**应聘基本条件**

* 计算机、电子信息、微电子、通信工程、自动化、电路设计类相关专业
* 本科及以上学历或有相关岗位经验
* 熟悉Linux和各类脚本语言
* 英语水平熟练

**简历投递**

fei.cao@cyansemi.com

一些图片：



